

代表者	代表取締役 櫻井 賢一	資本金	1,000万円
連絡担当者	代表取締役 櫻井 賢一	従業員数	12名
設立年月日	2011年7月7日	URL	https://www.sakura-seimitsu.co.jp

事業内容	<b>【加工内容】</b>
	○マシニングセンター加工 ○NC旋盤加工
	<b>【加工材質】</b>
	○アルミ、ステンレス、チタン、真鍮、鉄、樹脂
事業内容	<b>【主生産品目】</b>
	医療機器関連部品・半導体製造装置部品・ 航空機宇宙関連装置部品・ 自動車関連製造ライン部品・食品関連各種装置部品



【社屋】

工場・営業所	本社・工場
主要取引先	医療機器関連企業、半導体製造装置関連企業、航空機関連企業 他

品質等に係わる認定

薬機法に係わる許可

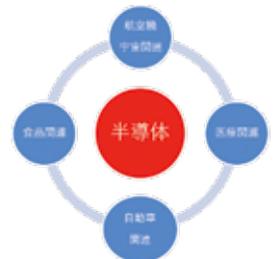
	機械・設備名	台数	仕様・型式
1	NC旋盤(LB3000EX・LB4000EXⅡ・LB45Ⅱ・LU45-M他)	5	ストロークX440 Z1060 φ660ほか
2	マシニングセンター(MU-500VA・MB-56VA・NVX5100・NVX5080他)	7	ストロークX1050 Y560 Z510ほか
3	ワイヤー放電加工機(SL400G)	1	ストロークX400 Y300 Z250
4	ロータリー精密平面研削盤 PRG6DX	1	チャックサイズ φ600mm
5	三次元測定機(CRT-P M544他)	1	測定範囲XxYxZ:~700×1000×600mm
6	測定顕微鏡(MF-A2017D)	1	XY軸測定ステージ 200×170mm
7	レーザーマーカ(LP-Z130)	1	

## 製品・技術の特徴

☆半導体製造装置部品の加工で培った技術を生かし、小型から大形(~φ700mm)の精密部品を加工

☆複雑形状部品の加工(溝加工・切欠き加工が必要な部品加工が得意)

☆試作・小ロット生産から量産まで対応



【事業分野】

## 加工サンプル



【S45C φ 400 相当部品】



【チタンφ 500 相当部品】



【アルミφ 130 相当部品】